

# 設備產業近況

華南投顧-林政謙  
2026.05.12

- 國內半導體廠商積極擴廠，帶動設備廠商2026年獲利成長幅度超過20%
- 先進封裝產能需求快速成長，讓國內設備廠陸續擴產，預估2027年後的需求量約年成長20%-40%
- 國內設備廠商的競爭優勢在於地域服務和價格較低
- 重點個股-3030德律、3131 弘塑

## AI、高效能運算帶動半導體設備資出持續成長

全球半導體設備銷售狀況			
時間	金額(億美金)	年增率	備註
2024	1239	2.5%	受AI、高頻寬記憶體 ( HBM ) 和高階製程(如2nm)拉動先進設備需求，帶動金額持續增加
2025	1330	7.3%	
2026(F)	1450	9.0%	先進封裝設備預估年成長15%、連續3年成長。
2027(F)	1560	7.6%	晶圓設備採購進入高原期，建廠潮減速

資料來源：SEMI、華南投顧整理

- 全球半導體設備銷售金額將持續成長、創新高
- 受惠AI相關投資，如先進邏輯、記憶體、先進封裝等需求，帶動全球半導體設備銷售金額持續成長，**預估2026年的年成長率為9%，以先進封裝的年成長15%最高。**
- 據國際半導體產業協會 ( SEMI ) 預測，2026年台灣半導體設備投資金額約為245億美元(2025年為210億)，位居全球第三，僅次於中國 ( 360億美元 ) 和韓國 ( 292億美元 ) 。
- 台灣半導體設備商受惠台積電2026年的資本支出提高到520億-560億美元，約60%-80%會用在先進製程，市場預期CoWoS相關產能會持續大幅擴張。
- 台灣廠商在**前段製程設備領域的自製率相對較低**，主要依賴國際大廠供應，隨著政府推動設備國產化，台灣廠商如京鼎(3413)等正積極投入前段設備的開發與製造；**台灣廠商在後段封裝設備領域具有較高的自製率 and 市場占有率**，特別是濕製程設備方面，如弘塑(3131)和辛耘(3583)等。

## 晶圓廠2025年、2026年持續擴大資本支出

應用領域	2025年規模(億美元)	YOY	2026年規模(億美元)	YOY
晶圓廠設備	1108	6.2%	1221	6.6%
邏輯與代工	602	2.8%	693	15%
DRAM	208	10.4%	221	6.2%
NAND	137	42.5%	150	9.7%
測試設備	81	14.7%	96	18.6%
封裝與組裝設備	57	16%	70	23.5%

資料來源：SEMI、華南投顧整理

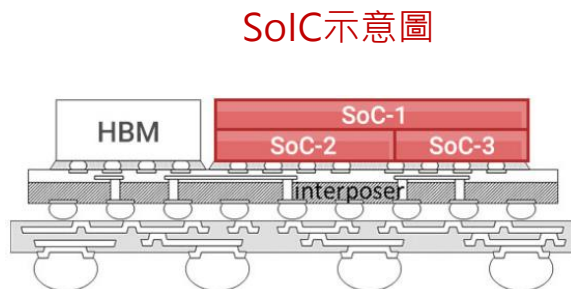
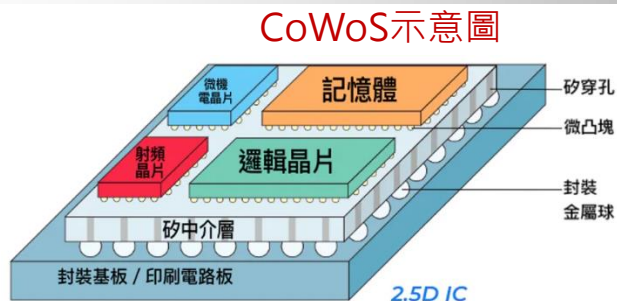
- 晶圓廠設備為主要應用領域，測試設備市場快速成長
- AI 與高效能運算快速發展：推動對高頻寬記憶體（HBM）與先進邏輯製程的需求，成為晶圓廠設備投資的主要驅動力。
- 先進製程技術提升：晶圓廠設備的成長受益於先進邏輯與記憶體應用的需求增加。
- 後段製程需求復甦：測試與封裝設備市場在2024年下半年開始復甦，預計2025年與2026年將持續成長。
- 亞洲國家持續擴產：中國、韓國與台灣預計在2025年至2027年間合計投資超過2500億美元於半導體設備，對台灣設備廠商有利(亞太地區的市佔約30%)。

## 台積電持續加速建置美國產能

擴廠規劃		製程節點	預估月產能	量產時間	備註
台灣(新竹/高雄)		2nm	4萬片 (初期)	4Q25	■ 未來數年將在台灣持續投資先進製程與先進封裝
美國	一廠	4nm	2.4萬片	4Q24	■ 海外第一個先進製程廠
	二廠	3nm/2nm	估3萬片	2027H2	■ 廠房已完工，2026年開始裝機
	三廠	2nm/A16	估3萬片	2030前	■ 2025年開始建設
	四廠	2nm/A16	估3萬片	(未定)	■ 申請施工許可中
	五~六廠	A14與更先進製程	估各3萬片	(未定)	
	先進封裝一、二廠	SOIC、COW、CoPoS	-	AP1:2028	■ 先進封裝一廠申請施工許可中
	第二塊地				■ 已在美國廠旁購買第二塊地 ■ 預計將興建另一個超大型晶圓廠群
日本	一廠	12/16/22/28/40nm	4萬片	4Q24	■ 生產CIS、車用晶片 ■ Sony持股20%、Denso持股10%
	二廠	6/7nm→4nm?	估6萬片	2027→ 依客戶需求決定	■ 著重於車用、HPC ■ 量產時程與導入的製程將依客戶需求決定
德國		12/16/22/28nm	4萬片	2027年→ 依客戶需求決定	■ 與Bosch、Infineon、NXP合作 ■ 台積電出資50%、持股70%

- 台積電已承諾在美國投資6座晶圓廠與2座封測廠，並已取得美國亞利桑那州第二塊地，將興建超大型晶圓廠群，德國廠與日本JASM二廠已動工。

# 台積電CoWoS持續供不應求



資料來源：台積電/數位時代

先進封裝 月產能(萬片)	2022年	2023年	2024年	2025年(F)	2026年(F)	2027年(F)	2028年(F)
CoWoS	0.8~0.9	1.5~1.6	3.5	7.5	12~13	13.5	15
SoIC	-	0.2	0.4~0.5	2.0	4.0	--	--

- **CoWoS未來主流為CoWoS-L**：CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate)為2.5D封裝，是先將系統單晶片、記憶體等裸晶置於中介層上用微凸塊(Micro Bump)連結，再封裝於基板上，可縮短晶片溝通距離、降低延遲、減少封裝體積、改善效能及功耗，依中介層材質可分為CoWoS-S(矽中介層)、CoWoS-R(RDL重分佈層)、CoWoS-L(RDL + LSI局部矽互聯)。
- **受惠AI需求強勁，CoWoS產能持續供不應求**：CoWoS-S成本較高，尺寸上限約為2500 mm<sup>2</sup>，代表產品有輝達H100/H200、超微MI300。CoWoS-R布線密度與導電性不如矽中介層，封裝尺寸較彈性，成本低，主要用於網通、邊緣AI，產能最少。CoWoS-L結合CoWoS-S與CoWoS-R的優點，可支援3000 mm<sup>2</sup>以上中介層，成本介於CoWoS-S與CoWoS-R間，為未來主流，其局部區域以矽中介層(LSI)串連晶片對晶片高速互連，其他區域則用RDL，由於Blackwell採用CoWoS-L，台積電2024年下半年已開始將CoWoS-S產能轉為CoWoS-L並持續擴產，2025年底整體CoWoS月產能較去年倍增，野村預估2025年CoWoS-L產能將占整體CoWoS產能60%。
- **SoIC目前有四家客戶**；SoIC(System-on-Integrated-Chips)是3D矽堆疊技術，藉堆疊多個SoC提升效能，分為主流銅對銅SoIC-X及SoIC-P(採用低成本Microbump)，AMD MI300率先採用，蘋果M5晶片採用成本較低的SoIC-mH，2025年底量產，NVIDIA Rubin GPU與博通也將採用。

## 全球先進製程擴張對台設備廠有利

封裝技術/ 每月萬片	2025年	2026年	特色	主要客戶
CoWoS	7.5-8	12-13	需求集中在 Hybrid Bonding、Die Attach、Underfill、AOI	NVIDIA、AMD、Google、亞馬遜
SoIC	2.0	4.0	核心在 Hybrid Bonding (Cu-Cu)、薄化/研磨、貼裝/對位	Apple
FOPLP / CoPoS	研發與測試	預計2028年量產	重點在 雷射/鑽孔、Compression Molding、大尺寸 AOI	應用於HPC/AI晶片
SoW	架構開發	預計2027年量產	晶圓處理、鍵合與堆疊、AOI檢測	應用於HPC/AI晶片

### ■ 國內設備廠商的競爭優勢：

- 電鍍/濕製程線方面：**辛耘**、**信紘科**（面板級清洗/電鍍整線與化學供應）；**志聖**在先進 PCB/載板與先封都有佈局（Desmear/PTH、貼膜/撕膜/烘烤）。
- 大面板 AOI/檢測：**德律**（先進封裝 AOI/X-ray/CT 線上強化）、**牧德**（PLP/先封外觀檢查機預計 2026 年 Q3 量產），都是面板級檢測的受惠者。
- 成型/模壓與整線工程：台灣系統整合商與模組商（**志聖**、**帆宣**等）可承攬大型模壓站、面板搬運與公用工程整合。
- 自動化/AMHS：**迅得**、**群翊**等在 PCB/載板與半導體廠房 AMHS（自動化物料搬運系統）已有布局，受東南亞擴廠與先封新產線推動。

## 電子廠商擴產帶動設備商獲利提升

分類	代號	個股	薄膜	黃光	蝕刻	擴散	CMP	濕製程	封裝	量測	自動化	CoWoS	SoIC
前段製程	3413	京鼎	○	○	○		○						
	3680	家登		○									
	8091	翔名	○	○	○	○							
	6196	帆宣		○	○	○	○	○	○	○		V	V
	6937	天虹	*		*				*				
後段製程	3583	辛耘	△	△	△			*		△		V	V
	3131	弘塑						*				V	V
	6187	萬潤							*	*	*	V	V
	2467	志聖							*			V	V
	6640	均華							*	*	*	V	V
	6664	群翊							*			V	V
	3455	由田								*		V	V
	3563	牧德								*		V	V
3030	德律								*		V	V	
自動化	6438	迅得									*	V	V
	2464	盟立									*		

\*自研機台 ○零組件/代工 △代理

■ CoWoS概念股集中在後段製程設備，包含濕製程、封裝用之撿晶與點膠機、AOI量測等

➤ 台灣前段製程設備商多為零組件加工、設備代工，少數如天虹為自研PVD/ALD設備，跟隨晶圓代工稼動率、國際設備大廠營運狀況變化，帶動設備廠商在2025年的獲利成長。

## 先進製程帶動國內設備商出貨成長

製程	機台	先進封裝技術	廠商
前處理/清洗	濕製程清洗/去膠/蝕刻槽	CoWoS, SoIC, FOPLP	辛耘(3583)、信紘科(6667)
RDL/薄膜製程	曝光/對位(Panel/Wafer Stepper)	CoWoS, FOPLP	系統整合：帆宣(6196)
電鍍/金屬沉積	銅/鎳/金電鍍線	CoWoS, FOPLP	辛耘(3583)
雷射加工	雷射鑽孔/修整	FOPLP, CoWoS	牧德(3563)
鍵合/貼合	Hybrid Bonder (混合鍵合)	SoIC, CoWoS	萬潤(6187)、弘塑(3131)
貼裝/打件	Die Bonder/Flip Chip	CoWoS, SoIC	萬潤(6187)、均豪(5443)
點膠/底填	Underfill Dispenser/Jetting	CoWoS, SoIC	弘塑(3131)、萬潤(6187)
切割/分割	Dicing Saw/雷射切割	CoWoS, FOPLP	整合商
檢測/量測	2D/3D AOI、X-Ray/CT	CoWoS, SoIC, FOPLP	德律(3030)、牧德(3563)、由田(3455)

### ■ 先進封裝需求強勁與設備國產化趨勢帶動國內廠商獲利成長

- 台設備廠商的優勢製程：點膠/底填、AOI/雷射、AMHS、自動化整合，而最高階的 Hybrid Bonder、先進電鍍/曝光機 仍由歐日美大廠壟斷，台廠多提供整線與週邊模組。
- 台積電 CoWoS、SoIC 於2026年將分別年成長40%和100%，供應鏈中濕製程/電鍍、點膠/底填、鍵合/貼裝、AOI/X-ray、AMHS/整線等受惠程度高。

## 國內主要半導體設備



濕製程清洗機



點膠機



雷射加工機



AOI檢查機



雷射切割機



電鍍機

## 國內半導體設備供應商的競爭優勢

類別	優勢
客製化與彈性	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 國內設備商與台灣/中國/東南亞 廠距離近，能快速依產線調整機構、軟體與自動化接口。</li> <li>◆ 群翊、迅得可海外新廠（泰國等）做整線 AMHS 規劃，比日系供應商更貼近客戶需求。</li> </ul>
在地服務與維護成本低	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 維護與零組件在地供應快，售後成本低於國際品牌。</li> <li>◆ 技術人員支援更即時</li> </ul>
結合半導體先進封裝趨勢	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 志聖、牧德、德律等已跨入 CoWoS/SoIC/PLP 檢測、貼膜、鍵合周邊領域。</li> <li>◆ 藉由 PCB 設備基礎，往高毛利的半導體封裝市場延伸，形成雙成長引擎。</li> </ul>
成本效益高但逐步升級	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 雖然在最高階精度（奈米級 AOI、Hybrid Bonder 本體）仍落後，但台廠已補位到「中高階應用 + 半導體封裝中間環節」。</li> <li>◆ 在 HBM/CoWoS 擴產下，這些中間站別需求爆發，正好是台廠優勢。</li> </ul>
價格	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 台廠機台通常比國際品牌便宜 20%–50%，能滿足大多數製程需求。</li> </ul>

### ■ 國內半導體設備商在服務與價格具有競爭優勢

- 客製化、在地服務、成本效益，是國內設備廠商的主要競爭優勢，隨著 IC 載板投資 + 先進封裝擴產 + PCB 東南亞移轉，台廠可在「性價比設備 + 整線自動化」這兩塊，持續擴大市場占有率。

## 國內主要設備商與半導體營收比重

廠商	主要產品	營收比重	備註
京鼎(3413)	薄膜沉積設備、蝕刻設備、系統組裝	97%	鴻海集團旗下，持股超過50%
弘塑(3131)	濕製程設備、化學品、設備代理	94%	高階晶圓封裝設備領導廠商，主要客戶有台積電、南亞科、聯電
萬潤(6187)	半導體封測設備、LED設備	92%	台積電轉投資，以封裝設備測試為主
辛耘(3583)	濕製程設備、再生晶圓、設備代理	90%	受惠CoWoS設備需求成長，主要客戶有台積電、聯電、世界先進
大量(3167)	CNC裁切機、PCB鑽孔機、半導體檢測機台	82%	主要客戶有台積電、聯電、日月光
均豪(5443)	先進封裝設備、AOI檢測設備	50%	從面板設備轉型，聚焦先進封裝市場，主要客戶有鴻海、聯電、日月光、台積電、漢磊
均華(6640)	先進封裝設備、AOI檢測設備	75%	
迅得(6438)	晶圓封裝與測試設備、自動化系統	50%	積極轉型半導體設備，客戶有日月光、欣興、南茂
東台(4526)	雷射晶圓切割設備、研磨/切割設備	31%	從工具機轉型切入半導體後段封裝製程

- 先進封裝需求強勁與設備國產化趨勢帶動國內廠商獲利成長
- 隨著AI、高效能運算等應用推動，先進封裝技術（如CoWoS、Fan-Out）需求大增，帶動相關設備廠商營收成長，為降低對國外設備的依賴，台灣政府與企業積極推動設備國產化，提供本土廠商成長機會。
- 傳統設備廠商如東台、大量科技等，透過技術轉型與產品多元化，切入半導體設備市場。

## 國內半導體設備商對2026年的看法均樂觀

國內廠商	2026年展望
致茂 (2360)	本業「電子電力量測 + 半導體/光子測試設備」動能最強，對 2026 年維持樂觀，營收目標雙位數成長、續創新高。
弘塑 (3131)	先進封裝 (2.5D/3D、CoWoS/SoIC 相關濕製程) 拉貨強，訂單能見度已排到 2026 上半年。2026 年受惠 AI 晶片先進封裝擴產與客戶擴充，2026 年產能維持滿載，二期廠放量後，有望帶來成本下降 + 出貨放大的雙重效果。
京鼎 (3413)	客戶 (含應用材料 AMAT) 相關訂單穩健；記憶體 (HBM/先進 DRAM) 與先進製程資本支出帶動設備需求，AI 伺服器/HBM 需求延續至 2026 年。
辛耘 (3583)	以設備 + 再生晶圓為雙成長主軸，2026 年在半導體擴產 (先進製程/先進封裝) 與再生晶圓需求支撐下，公司訂單展望在 2026 年仍偏樂觀。
群翊 (6664)	聚焦乾製程設備 (壓膜、塗佈、烘烤等) 切入 AI 用高階 PCB、IC 載板、FOPLP (扇出型面板級封裝)；受高階 PCB/先進封裝趨勢帶動，能見度延伸至 2026 年。
萬潤 (6187)	受先進封裝 (CoWoS/FOWLP) 產能擴張帶動，點膠、AOI、自動化與光耦合 (矽光子/FAU) 等設備需求旺盛；2026 年隨著先進封裝產能倍增計畫與矽光子導入擴大，萬潤對 2026 年營運維持樂觀。
德律 (3030)	AI 伺服器帶動量測商機，2026 年 AI 伺服器擴產 → 帶動高階板與封裝檢測設備需求 (公司視覺 AI 與機器人應用可望持續放量)。
尖點 (8021)	AI 高速運算供應鏈掀起「搶針潮」，2025 年下半年已啟動擴產計畫，主要聚焦鑽針產能，新產能將在 2026 年第一季全數開出，使月產能由 3,100 萬支提升至 3,500 萬支。



弘塑 UFO-300C系列



弘塑 UFO-150C系列

濕製程設備廠商	產品與市場地位
弘塑 (3131)	單晶圓旋轉清洗機、複合式濕洗機、酸槽設備，國內市占率最高，目前為台積電先進封裝新製程濕式設備的最大國產供應商。
辛耘(3583)	自製濕製程清洗設備、單晶圓旋轉機、暫時性鍵合設備，台積電CoWoS關鍵濕製程設備的主要供應商之一，自製設備產能持續滿載。

- CoWoS產能持續成長，帶動濕製程設備需求量快速成長
- 半導體濕製程設備主要分為批次式與單晶圓式兩大類，單晶圓清洗機，針對單片晶圓進行精密噴灑或旋轉清洗，適合 12 吋晶圓及先進製程（CoWoS 封裝），因台積電大幅增加相關產能，帶動設備廠商出貨量快速成長。

## 萬潤、牧德、德律、群翊2025年的毛利率都超過50%

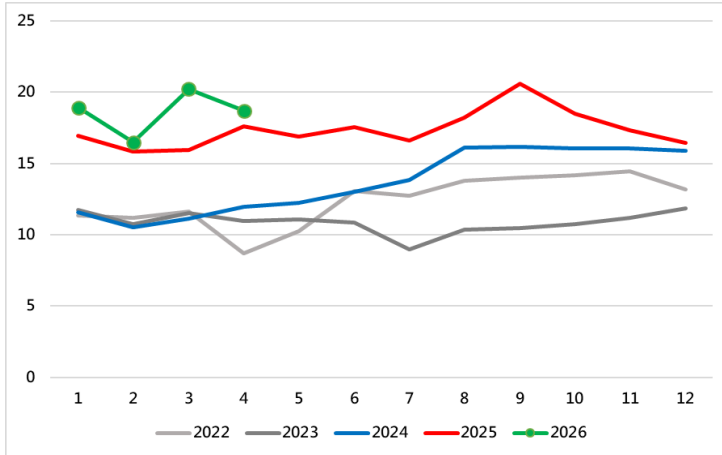
股票代號	股票名稱	毛利率				營益率			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
3413	京鼎	29.9	26.2	26.1	25.6	19.9	15.6	16.2	16.0
3680	家登	48.7	48.0	44.2	41.3	24.3	20.9	18.2	13.8
8091	翔名	38.7	35.6	34.1	34.2	24.7	17.9	16.7	17.5
3583	辛耘	37.0	29.9	33.5	33.5	12.6	11.5	13.9	13.9
3131	弘塑	43.5	42.0	45.3	40.7	20.4	19.6	22.2	22.9
6187	萬潤	47.9	49.1	54.3	54.3	20.7	25.8	30.0	30.0
2467	志聖	35.6	41.5	41.2	43.0	13.6	11.1	13.2	13.9
3563	牧德	57.8	57.6	61.3	61.3	30.1	20.6	32.8	32.8
3030	德律	57.4	59.5	58.4	58.4	32.1	28.9	29.3	29.3
6438	迅得	28.5	26.6	23.5	23.5	14.6	10.9	6.4	6.4
2464	盟立	17.4	18.4	18.6	18.6	3.3	1.5	-2.5	-2.5
6640	均華	40.2	37.8	39.1	39.1	16.6	16.9	11.8	11.8
6664	群翊	42.3	52.0	58.8	58.8	25.4	40.0	35.5	35.5

## 弘塑、辛耘、志聖、德律的獲利持續成長

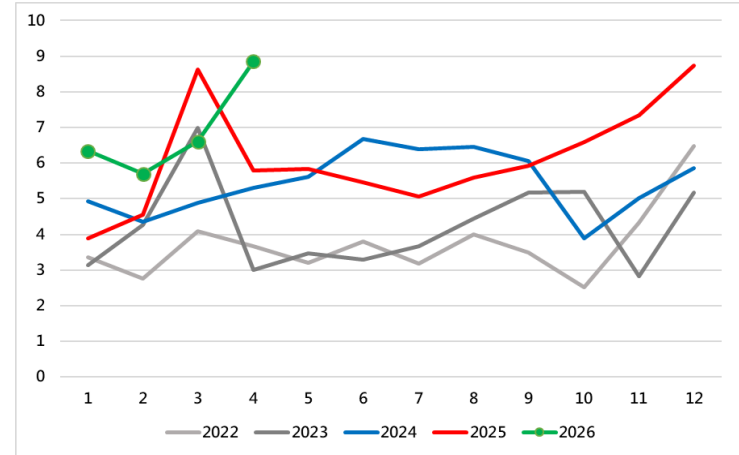
股票代號	股票名稱	EPS						稅後純益年增率		
		2023	2024	2025	2026 (同業預估)	2026(F)	PE	2022	2023	2024
3413	京鼎	20.48	25.22	22.18	29.4	29.22	10.8	56%	-14%	31%
3680	家登	10.24	12.32	9.18	15.23	15.24	36.7	177%	-3%	29%
8091	翔名	5.98	7.5	5.28	7.63	7.06	27.1	66%	-36%	32%
3583	辛耘	8.1	11.54	15.18	18.77	18.58	42.4	35%	14%	43%
3131	弘塑	21.56	29.07	45.48	68.96	66.33	44.3	8%	-15%	37%
6187	萬潤	1.7	14.57	17.56	27.2	18.19	58.8	-8%	-72%	848%
2467	志聖	3.12	4.8	5.81	8.04	10.92	49.2	9%	-32%	48%
6640	均華	3.57	14.62	12.84	22.83	38.45	36.3	46%	-56%	309%
6664	群翊	12.65	16.97	15.17	18.35	17.92	24.7	87%	13%	40%
3563	牧德	8.21	5.52	17.74	25.24	21.56	37.2	-28%	-29%	-25%
3030	德律	4.24	7.78	9.41	12.66	12.85	30.3	62%	-48%	83%
6438	迅得	8.89	7.63	7.84	8.64	10.25	16.6	2%	-3%	-11%

# 家登、翔名2026年的營收成長幅度較高

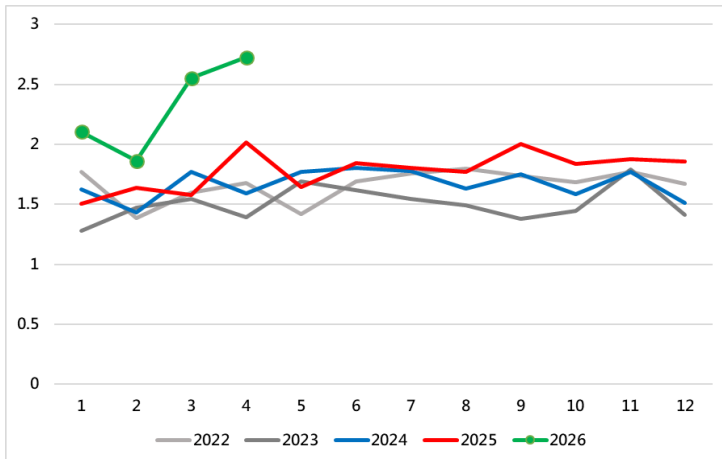
京鼎



家登

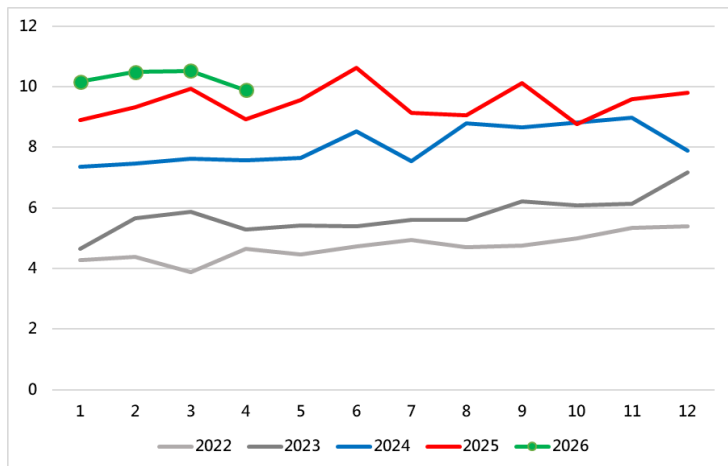


翔名

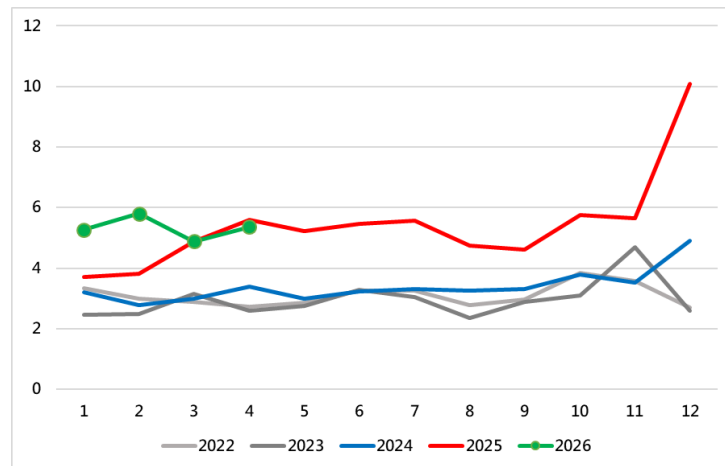


# 萬潤、志聖2026年的營收成長幅度較高

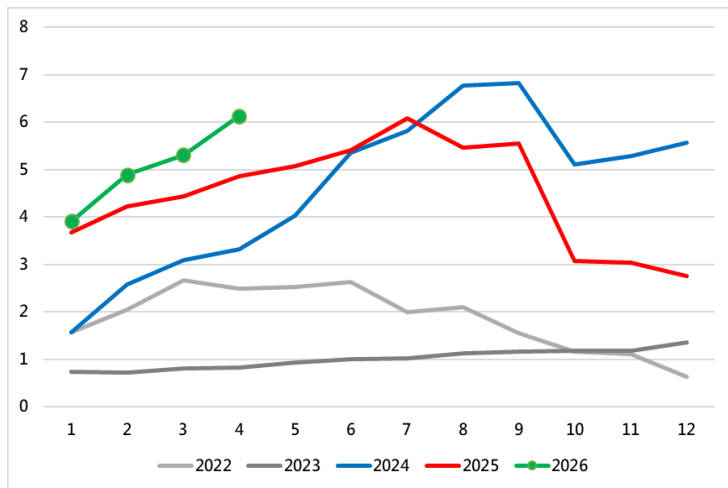
辛耘



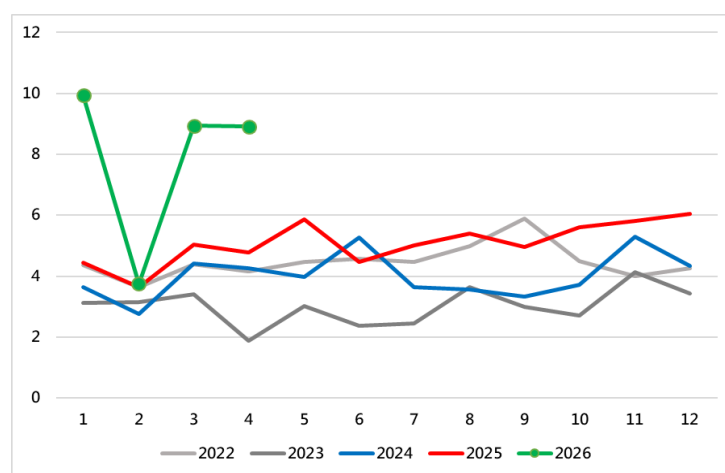
弘塑



萬潤

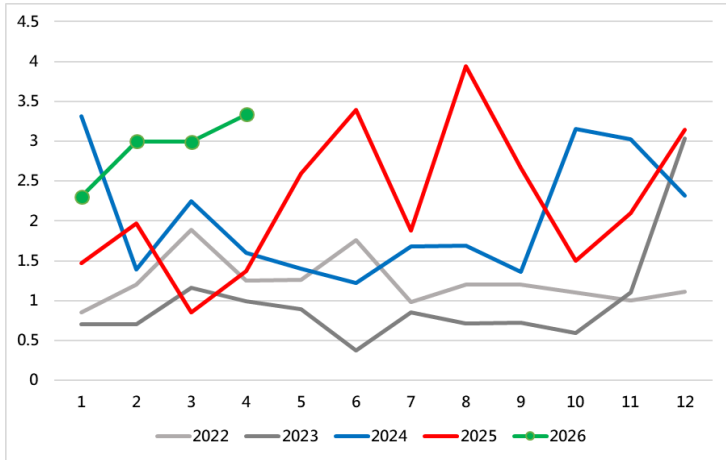


志聖

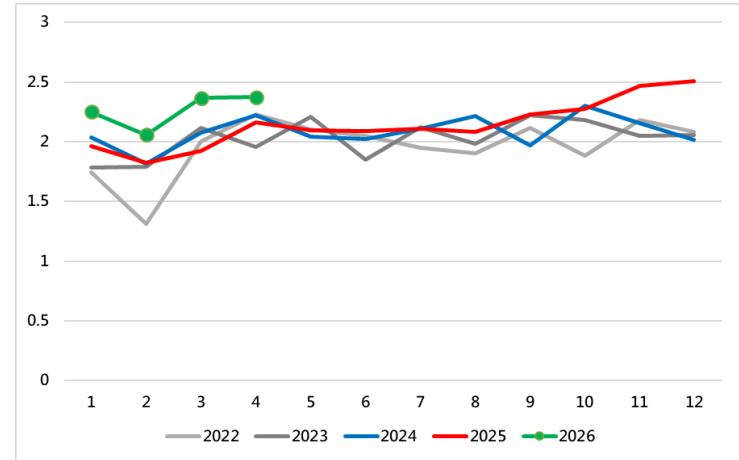


# 均華、德律2026年的營收成長幅度較高

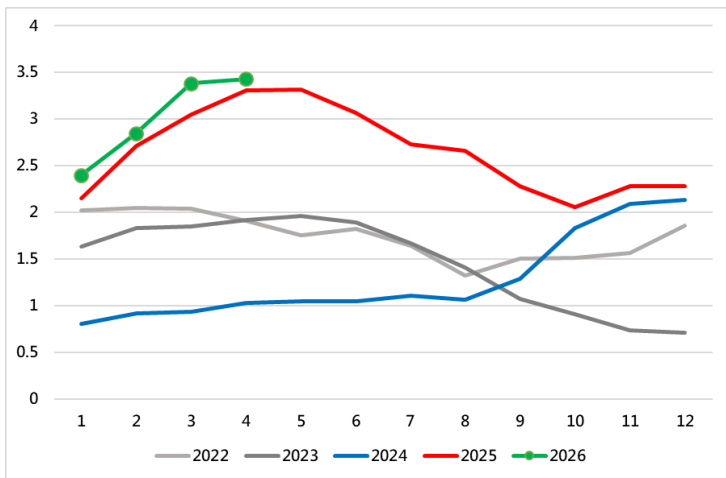
均華



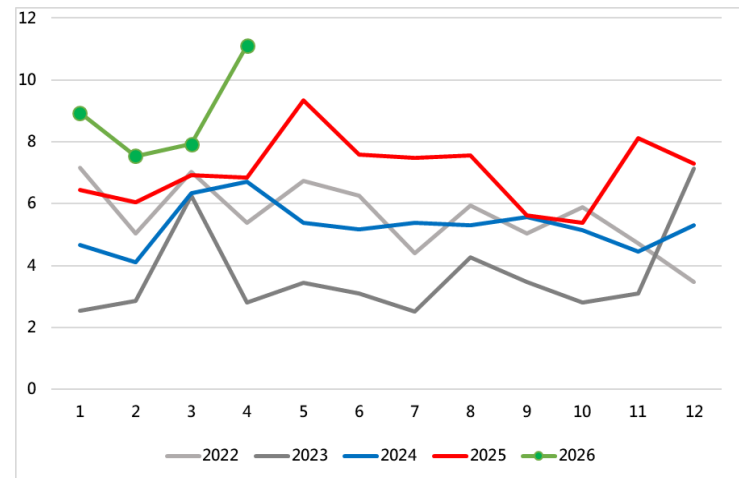
群翊



牧德



德律



年/季	營收 (億元)	毛利率 (%)	營益率 (%)	業外收支率 (%)	股本 (億元)	稅前盈餘 (億元)	稅前 EPS(元)	稅後 EPS(元)
2022	67.1	57.4	32.1	4.3	23.6	24.5	10.39	8.13
2023	44.4	59.3	27.3	0.7	23.6	12.6	5.31	4.24
2024	63.6	59.5	31.9	2.1	23.6	21.8	9.22	7.78
2025	84.7	58.4	35.3	0.1	23.6	30.0	12.69	10.49
2026(F)	105.6	57.9	35.5	2.9	23.6	38.3	16.20	12.85
202601	24.4	60.3	38.2	0.2	23.6	10.1	4.29	3.50
202602(F)	28.0	58.9	37.8	-2.2	23.6	10.0	4.22	3.54
202603(F)	26.2	56.9	32.4	1.5	23.6	8.9	3.76	2.93
202504(F)	27.0	55.8	33.9	0.5	23.6	9.3	3.93	2.87

## 營收結構

單位：億元	2025		2026(F)	
	營收	比重	營收	比重
銷貨收入	82.4	97%	103.1	98%
維修服務	2.3	3%	2.5	2%

- 公司為電子、資訊與通訊產業的自動測試設備領導者，在美國、馬來西亞、中國大陸、德國、日本與韓國等地設有子公司，並且在超過30個國家設立代理商。
- 公司產品主要分自動光學檢測設備與電路板測試機兩大項，提供一條龍電路板組裝檢測服務。

## 先進封裝帶動德律AOI需求成長

營收(億元)	Q1	Q2	Q3	Q4
2025年	19.4	23.8	20.7	20.8
2026年	24.4	28.0	26.2	27.0
QOQ	17.3%	14.7%	-6.4%	3.1%
YOY	25.8%	17.8%	26.7%	29.7%

### ■ 公司營運狀況：

- 隨台積電、日月光等加碼CoWoS、InFO、SoIC等封裝技術，帶動3D AOI/AXI (X光檢測) 設備需求快速升溫，公司切入半導體市場，半導體檢測設備多用於後段封裝，Surface AVI、SWIR Crack等產品檢測設備持續出貨中，客戶為OSAT廠商。
- 公司推出多款半導體檢測設備，目前AXI於半導體應用比率不高，但在未來相當有機會，只要持續提升X-ray的精度至到2um以下，即能滿足先進封裝穿透式檢測需求。

### ■ 營收成長動力：

- 隨工廠走向自動化發展、良率需求提高，有利於在線型機種銷售，隨元件尺寸越來越小，有利於持續投入資源進行研發的公司，可於精度與量測穩定度上與競爭對手拉開差距。
- AI伺服器板尺寸放大、檢測點數增加，對3D AOI、AXI及高速量測設備需求提升，有助高階產品出貨。
- 隨先進封裝需求快速成長，帶動相關AOI檢測需求，加上藍海市場產品占比提高，帶動公司毛利率上升。

年/季	營收 (億元)	毛利率 (%)	營益率 (%)	業外收支率 (%)	股本 (億元)	稅前盈餘 (億元)	稅前 EPS(元)	稅後 EPS(元)
2022	37.2	43.5	20.4	0.0	2.9	9.3	31.99	24.73
2023	35.4	42.0	19.6	0.0	2.9	7.5	25.64	21.11
2024	40.7	45.3	22.2	0.0	2.9	10.5	35.84	28.95
2025	65.1	42.1	24.3	2.1	2.9	17.6	60.31	45.48
2026(F)	78.6	44.6	28.3	6.7	2.9	27.5	94.02	66.33
202601(E)	16.0	33.8	13.2	22.5	2.9	5.7	19.48	16.11
202602(F)	19.8	42.3	25.5	3.6	2.9	5.8	19.69	13.19
202603(F)	19.4	49.4	34.9	1.2	2.9	7.0	23.97	17.26
202504(F)	23.5	49.8	35.4	3.0	2.9	9.0	30.89	19.77

## 營收結構

單位：億元	2025		2026(F)	
	營收	比重	營收	比重
機台設備	39.6	65%	55.0	70%
化學品	12.2	20%	15.7	20%
代理、軟體	9.1	15%	7.59	10%

- 公司為電子、資訊與通訊產業的自動測試設備領導者，在美國、馬來西亞、中國大陸、德國、日本與韓國等地設有子公司，並且在超過30個國家設立代理商。
- 公司產品主要分自動光學檢測設備與電路板測試機兩大項，提供一條龍電路板組裝檢測服務。

## 先進封裝需求增加，帶動公司獲利成長

營收(億元)	Q1	Q2	Q3	Q4
2025年	12.4	16.3	14.9	21.5
2026年	16.0	19.8	19.4	23.5
QOQ	-25.7%	23.8%	-1.8%	21.1%
YOY	28.7%	21.2%	29.9%	9.3%

### ■ 公司營運狀況：

- 公司目前營收約7成來自台灣，中國大陸為第二大市場，其他區域也逐步切入，美國布局目前仍以後段服務為主。
- 先進封裝需求持續增加，公司積極布局COPOS與WMCM兩大技術路線，目前在COPOS專案比重較高，客戶端組織已在整備，預期將帶動後續需求。

### ■ 營收成長動力：

- 先進封裝需求持續增加，公司積極布局COPOS與WMCM兩大技術路線。COPOS以310×310方形載具取代傳統12吋圓片，對速度與搬運要求更高，公司在COPOS專案比重較高，客戶端組織已在整備，預期將帶動後續需求。
- 目前接單已達2026年上半年，受惠新廠即於2025年第四季投產，2026年產能可增加1倍。

## 金管證字號

(114)金管投顧新字第015號

## 免責聲明

本項研究報告僅提供本公司會員參酌，且純粹屬於研究性質，並不保證報告內容的完整性與精確性，亦完全無意影響客戶買賣股票的任何投資決定。報告中的各項意見與預測，是得自於本公司信任為可靠的來源，受到特定的判斷日期之時效性限制，若嗣後有任何變動，本公司不做預告，也不會主動更新。投資人做任何決策時，必須自行謹慎評估相關風險，並就投資的結果自行負責。本研究報告的著作權為華南投顧所有，嚴禁抄襲、引用、對外傳送或轉載。